

# Microscan

Gamybos linijoje veikiančios spausdintinių elektroninių plokščių visapusiškos kontrolės sistemos sukūrimas / Microscan

**Projekto kodas:** COOP-CT-2003-508613

**ES programa:** Framework Programe 6 (FP6)

**Projekto trukmė:** 2004.11.01-2007.03.30

## Projekto tikslas

Taikant įvairias neardomas vertinimo metodikas (rentgenografiją, infraraudonuosius spindulius ir akustinius metodus) sukurti spausdintinių elektroninių plokščių visapusiškos kokybės kontrolės sistemas.

## Ultragarso institutas

Sukūrė naują signalų apdorojimo metodą, paremtą dažninio spektro analize ir išnaudojantį informaciją apie komponento, kaip daugiasluoksnės struktūros akustines savybes. Metodas patikrintas, taikant jį didelės galios diodų neardantiesiems bandymams.

## Projekto partneriai

X-Tek Systems Ltd (Jungtinė Karalystė), Lot Oriol GmbH & CoKG (Vokietija), Machine Vision Products Inc. (Jungtinė Karalystė), Gentech Electronics Ltd (Airija), Beta Electronics Ltd (Airija), Ultrasonics Sciences Ltd (Jungtinė Karalystė), Inboard Leiterplattentechnologie GmbH (Vokietija), Goodrich Control Systems Ltd (Jungtinė Karalystė), Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderungder AngewandtenForschung E.V. (Vokietija), TWI (Jungtinė Karalystė), Kauno Technologijos Universitetas (Lietuva).

**Projekto aprašymas anglų kalba:** <http://ktu.edu/umi/en/content/microscan>

[| puslapio viršų](#)

## SUSIJUSI INFORMACIJA

1. **O. Tumšys, L. Mažeika, R. Kažys, R. Raišutis.** Application of the signal processing in the case of ultrasonic inspection of PCB components. Ultragarsas. 2007. Vol. 62. No. 3. P. 16-19. [/pdf/](#)
2. **R. Raišutis, O. Tumšys, R. Kažys and L. Mažeika.** Application of ultrasonic iterative deconvolution technique to the case of internal defect detection in multi-layered PCB components. Insight. 2010. Vol. 52. No. 1. p. 27-33. [/pdf/](#)

